

東芝キャリア(株)RoHS規制物質調査表(不含有証明書)

回答日 2006/7/11 YYYY/MM/DD

会社名	〇〇〇〇株式会社
部署名・役職	品質保証部 部長
住所	富士市××町△△番地
責任者	富士 太郎

問い合わせ先氏名	富士宮 一郎
TEL	0545-62-5000
FAX	0545-62-5500
E-MAIL	ichiro.fujinomiya@net.co.jp
備考	

問い合わせ先氏名と連絡先(TEL/FAX/E-MAIL)を記入をお願いします。

責任者印

必ず、責任者印を押してください。

当社は、下記の回答内容が正しいことを保証します

同一構成であれば、列記できません。

図番	部品名称	製造メーカー名	メーカー型番	質量(g)	RoHS閾値判定 OK
D0101010	BODY-PMV	〇〇製作所	UKV-2000	50	OK

含有しているものは、必ず含有理由を記載してください。

使用部位の詳細

東芝キャリアは、規制物質の製品への含有を限りなく

分析データまたは、部位の不含有証明書が必要です。

RoHS閾値の基準に取引組んでいませ

適用除外物質がある場合は、表1の番号を記入してください。

No	使用部位 (構成部品名)	材質	各部位RoHS規制物質含有率(ppm)							分析 データ No	不含有 証明 No	規制物質の 含有理由 (適用除外を含む)	RoHS NO.	判定 結果	質量 (g)	備考
			カドミウム 及びその化 合物*1	六価クロム 化合物	鉛及びその 化合物	水銀及びそ の化合物	ポリ臭化ビ フェニル類	ポリ臭化ジ フェニル エーテル類 PBDE	リミット							
			Cd	Cr+VI	Pb	Hg	PBB	PBDE								
1	ケース	SUS305	<10	N.D	<10	N.D	N.D	N.D	1	2	不純物	OK	25			
2	ばね押さえ	C3604	<50	<5	<31800	<1	N.D	N.D	3	—	加工性向上(適用除外)	③ OK	2			
3	スリーブ	SUS304	<0.01	N.D	<1	N.D	N.D	N.D	4	—	不純物	OK				
4	クロメート処理部位	三価クロム	N.D	<100	N.D	N.D	N.D	N.D	5	—	不純物	OK				
5	ばね1	SUS304	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	6	—	不純物	OK				
6	ばね受1	PPS	<5	<20	<5	<5	<5	<5	7	—	不純物	OK	3			
7	スライダ	SUS304	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	8	—	不純物	OK	1			
8	マグネット	PPS+フェライト	<50	—	—	—	—	—	9	—	不純物	OK	1			
9	ブッシュ	SUS303	—	—	—	—	—	—	10	11	不純物	OK	3	PBB,PBDEの意図的使用なし		
10	オネジ	SUS303	—	—	—	—	—	—	12	—	不純物	OK	2	PBB,PBDEの意図的使用なし		
11	メネジ	PPS	<5	—	—	—	—	—	13	—	不純物	OK	1			
12	固定金具	SUS304	—	—	—	—	—	—	14	—	不純物	OK	0.5	PBB,PBDEの意図的使用なし		
13	ワッシャ	C2680	<5	—	—	—	—	—	15	—	不純物	OK	0.5			
14	口吻材	—	—	—	—	—	—	—	16	—	不純物	OK	0.5	PBB,PBDEの意図的使用なし		
15	ロットNo.用インク	—	<100	—	—	—	—	—	17	—	不純物	OK	—			

<含有率の表記方法>
 N.D : 測定を試みたが、検出限界以下
 — : 意図的に含有していないとメーカーが判断し、測定していない。(備考欄に記載必要)
 <*** : 未満
 * なお、東芝キャリア(株)への納入品全部に対しての内容とみなします。

測定していないものに対して必要です。

全部位に対して必要です。

それぞれの部位の質量を記入してください。

注1) 使用部位の定義
 使用部位とは、機械的に分離できない状態の物質又は機械的に分離できない状態の材料にまで分解したものを言う。
 * 1 機械的に分離できないとは、ねじ外し、切断、破碎、粉碎、及び研磨等の機械的な操作によって分離できないことをいう。
 * 2 含有率算出事例(詳細は算出事例シート参照)
 ① クロメート処理したネジ/めっき鋼板等→メッキ層は分離可能
 ② 電子部品の半田めっきされたリード→半田は分離可能
 ③ 樹脂部品等に添加された物質→分離不可能

注2) カドミウムの含有
 黄銅中に不純物として含有する場合があります、管理材を使用し100ppm以下であることを確認すること。
 (リサイクル材の使用は特に注意を要する。
 注3) 適用除外例
 [「鉛の閾値」]
 ・鋼材中の0.35wt%までの鉛
 ・電子部品のガラス及びセラミック部品に含まれる鉛
 ・アルミ材中の0.4wt%までの鉛
 ・高融点半田(鉛含有率85%以上)に含まれる鉛
 ・銅合金材中の4wt%までの鉛

東芝キャリア(株)RoHS規制物質調査表(不含有証明書)

回答日 YYY/YY/MM/DD

会社名	
部署名・役職	
住所	
責任者	

問い合わせ先氏名	
TEL	
FAX	
E-MAIL	
備考	

責任者印

当社は、下記の回答内容が正しいことを保証します。

図番	部品名称	製造メーカー名	メーカー型番	質量(g)	RoHS閾値判定 OK, NG

使用部位の詳細 **東芝キャリアは、規制物質の製品への含有を限りなくゼロに近づけるべくRoHS閾値の50%化を目標に取り組んでいます。**

No	使用部位 (構成部品名)	材質	各部位RoHS規制物質含有率(ppm)						分析 データNo	不含有 証明書 No	規制物質の 含有理由 (適用除外を含む)	適用除外 No.	RoHS規制 閾値 判定 OK, NG	重量 (g)	備考
			カドミウム 及びその化 合物 *1 Cd	六価クロム 化合物 Cr+VI	鉛及びその 化合物 Pb	水銀及びそ の化合物 Hg	ポリ臭化ビ フェニル類 PBB	ポリ臭化ジ フェニル エーテル類 PBDE							
			100以下	1000以下	1000以下*2	1000以下	1000以下	1000以下							
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

注1)使用部位の定義
 使用部位とは、機械的に分離できない状態の物質又は機械的に分離できない状態の材料にまで分解したものを言う。
 * 1機械的に分離できないとは、ねじ外し、切断、破碎、粉碎、及び研磨等の機械的な操作によって分離できないことをいう。
 * 2 含有率算出事例(詳細は算出事例シート参照)
 ①クロメート処理したネジ/めっき鋼板等→メッキ層は分離可能
 ②電子部品の半田めっきされたリード→半田は分離可能
 ③樹脂部品等に添加された物質→分離不可能

注2)カドミウムの含有
 黄銅中に不純物として含有する場合があります、管理材を使用し100ppm以下であることを確認すること。
 (リサイクル材の使用は特に注意を要する。
注3)適用除外例
 [「鉛の閾値」]
 ・鋼材中の0.35wt%までの鉛 ・電子部品のガラス及びセラミック部品に含まれる鉛
 ・アルミ材中の0.4wt%までの鉛 ・高融点半田(鉛含有率85%以上)に含まれる鉛
 ・銅合金材中の4wt%までの鉛

<記入方法>

記入項目	記入内容	
回答日	責任者印を押印した日付を西暦((例)2006/07/10)で記入をお願いします。	
責任者名	記載した内容について、保証する人の氏名の記入をお願いします。責任者とは、品質・環境部門の責任者または事業責任者です。	
	部署名・役職	責任者の部署名と役職を記入をお願いします。
	住所	責任者の所属する部署の住所を記入をお願いします。
問合わせ先氏名	内容についての問合わせを受ける人の氏名を記入をお願いします。部門が分かれば部門も記載をお願いします。	
	TEL	問合わせ先の電話番号を記入をお願いします。
	FAX	問合わせ先のFAX番号を記入をお願いします。
	E-MAIL	問合わせ先担当者のE-MAILアドレスを記入をお願いします。
備考	責任者/記入者に関して特記事項があれば記載してください。	
責任者印	部署印をお持ちであれば部署印を押印をお願いします。お持ちでなければ個人印でも可です。	
図番	弊社からRoHS対応要求している図番の記入をお願いします。同一構成であれば、列記できます。	
	部品名称	図面中部品名称の記入をお願いします。
	製造メーカー名	製造メーカー名記入をお願いします。
	メーカー型番	メーカーでの型番があれば記載をお願いします。
	質量	gで記入をお願いします。
	RoHS閾値判定	各図番に対してのRoHS閾値判定(OK/NG)をお願いします。
使用部位(構成部品名)	使用部位とは、機械的に分離できない状態の物質又は機械的に分離できない状態の材料にまで分解したものを示しています。 * 1: 機械的に分離できないとは、ねじ外し、切断、破碎、粉碎、及び研磨等の機械的な操作によって分離できないことを示しています。 * 2: 含有率算出事例(詳細は算出事例シート(図1)参照) ①クロム処理したネジ/めっき鋼板等→メッキ層は分離可能 ②電子部品の半田めっきされたリード→半田は分離可能 ③樹脂部品等に添加された物質→分離不可能	
材質	JISの番号があれば、JIS番号を記入をお願いします。無いものは、俗称を記入をお願いします。	
各部位RoHS規制物質含有率(%)	<表記記号の意味> 下記3種類の表記方法での記載としてください。	
	N.D	: 検出不能(測定を試みたが、検出限界以下)
	—	: 意図的に含有していないとメーカーで判断し、測定していない。(備考欄に記載必要)
	<****	: ****未満
<p>なお、東芝キヤリア(株)への納入品全体に対しての不含有証明との位置づけですので、特定部品の検査値でなく、全体を証明する形での記載としてください。</p> <p><六価クロムについて> クロメート処理しているものについては、表記入の他に「クロメート処理内容確認書」を提出をお願いします。</p>		
分析データNo.	分析データは、記載値を検証するためのデータです。	分析データNo.と不含有証明書No.は、整理して明確にしてください。
不含有証明書No.	不含有証明No.は、含有率データを部材購入先から入手した場合に、その証明書No.を記載してください。	
規制物質の含有理由(適用除外を含む)	規制物質が含有されている理由を記入ください。適用除外に該当するならば、その旨記載してください。(適用除外項目については、表1で示す。)	
適用除外No.	表2で示した該当適用除外No.を記入してください。	
RoHS規制閾値判定	各部位に対してのRoHS閾値判定(OK/NG)をお願いします。	
質量(g)	それぞれの部位の質量を記入してください。0.1g以下は、—で記載をお願いします。	
備考	測定していないものについては、記載が必要です。その特記事項があれば、記載してください。	

<特記事項>

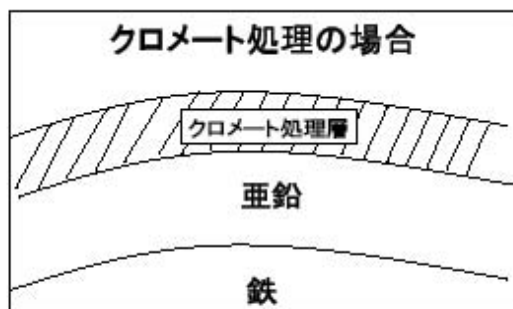
- (1) 責任者名の記入、印が無いものは無効です。
- (2) RoHS規制物質が入っていると思われるものは、全部リスト化して記入してください。
- (3) すべての構成部位の材料について大きさや長さの違いのみで同一の場合は、表に列記できます。
- (3) OK判定したバックデータ(分析データ／不含有証明書)があれば、提出してください。各々の書類がどのデータのバックデータに相当するか整理して提出してください。
- (4) 適用除外物質は、欧州委員会の決定において時々刻々と変わりますので、内容が変わりましたら都度お知らせします。
現在は、2006年5月時点の適用除外物質を表1に纏めてあります。
- (5) クロメート処理を行っているものについて以下をご確認ください。
 - ① 不含有証明書のほかに「クロメート処理内容確認書」も提出お願いします。
 - ・社名／所属・役職／住所／責任者／責任者印が必要です。
 - ・表内6つの質問事項に回答お願いします。
 - ② バックデータとして分析データを添付する際は、分析方法と条件を記載してください。
 - ③ 「クロメート処理内容確認書」は、クロメート処理初期において、六価クロムが混入することなく適切に処理されていることを確認するためのものです。保管時に経時変化や外乱などによって、化学的な反応や物理的な反応によって、六価クロムが生成される場合が、全く考えられないわけではありません。従って、東芝キャリア(株)に納品する際に、出荷時点での製品に六価クロムが1000ppm以下であることが重要ですので、必ずご確認ください。

図1:含有率算出事例

含有率は均質物質(使用部位)毎に算出します。使用部位の考え方は以下を参照してください。

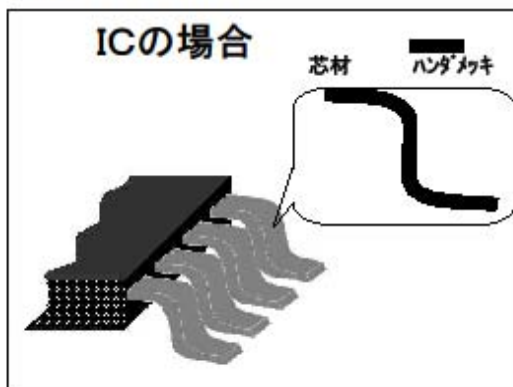
①クロム処理したネジ/めっき鋼板等→めっき層は分離可能

鉄等の母材と亜鉛等の下地メッキ及びクロメート処理層の3つの使用部位(分母)に分けてそれぞれ算出する。



②電子部品の半田めっきしたリード→半田は分離可能

銅材等の導体材料と半田メッキ層の2つの使用部位(分母)に分けてそれぞれ算出する。



③樹脂部品等へ添加された物質→分離不可能

母材の樹脂に添加され均質に混じり合っている物質は、機械的には分離が不可能な為樹脂材料全体を使用部位(分母)として算出する。
樹脂部材にインサート成型された金属部品等は、機械的に分離が可能な為、樹脂材料とは別の使用部位として算出を行う。

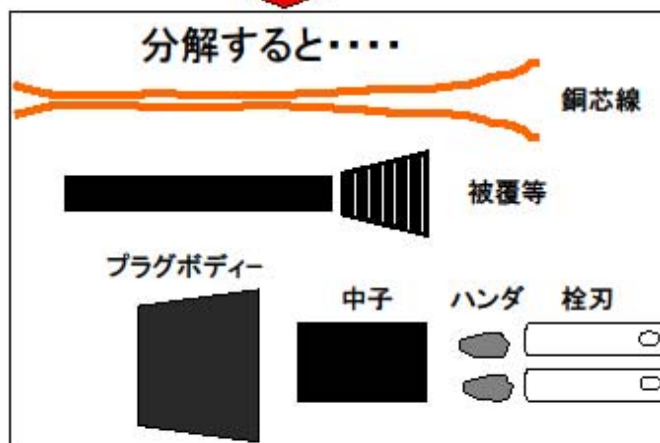
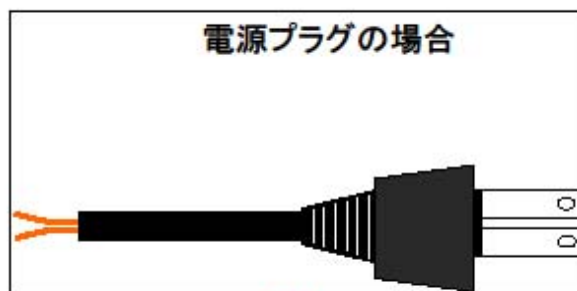


表1:適用除外項目

<適用除外項目:2006-5>

- ①ランプ中の水銀
 - ・小型蛍光灯内の水銀でランプごとに5mgを超えないもの
 - ・一般用途の直管型蛍光灯内の水銀で以下を越えないもの(ハロリン酸:10mg、通常寿命の三リン酸:5mg、寿命が長い三リン酸:8mg)
 - ・特殊用途の直管型蛍光灯内の水銀 ・その他のランプ内の水銀
- ②ブラウン管・電子部品・蛍光管のガラス中の鉛
- ③鋼材中の0.35wt%まで、アルミ材中の0.4wt%まで、及び銅合金中の4wt%までの鉛
- ④高融点ハンダに含まれる鉛 (即ち鉛含有率が85%以上の鉛ハンダ合金)
- ⑤サーバー用、ストレージ用、ストレージ・アレイ・システム用、スイッチング/シグナリング/電送用ネットワークインフラ装置用および通信管理ネットワーク用ハンダ中の鉛
- ⑥電子セラミック部品に含まれる鉛 (例;ヒヅエレクトロニックデバイス)
- ⑦一部禁止以外の電気接点中及びカドミウム表面処理中のカドミウム、カドミウム合金
- ⑧吸収型冷蔵庫中のカーボンスチール冷却システム防錆用六価クロム
- ⑨PBDEのうちDeca-BDE (J-MoSS対応では除外項目でないため、RoHS対応品でも除外としません)
- ⑩鉛青銅製の軸受胴とブッシングに含まれる鉛
- ⑪コンプライアント・ピンコネクタシステムに使用される鉛
- ⑫熱伝導モジュール型Cリング向けコーティング材料用の鉛
- ⑬光学・フィルタガラス中の鉛とカドミウム⑭マイクロプロセッサのピンとパッケージとの間の接合用であって3種類以上の成分で構成され鉛含有率が80wt%超で85wt%未満のハンダ中の鉛
- ⑭マイクロプロセッサのピンとパッケージとの間の接合用であって、3種類以上の成分で構成された鉛の含有率が80wt%超で85wt%未満のハンダ中の鉛
- ⑮集積回路フリップチップパッケージの内部の半導体ダイとキャリアーの間の有効な電気接続を完全にしているハンダ中の鉛
- ⑯シリカコーティングを施した直線形白熱電球中の鉛
- ⑰プロ用途の複写用高輝度放電(HID)ランプ中の放射物質としてのハロゲン化鉛
- ⑱BSP(BaSi2O5:Pb)の様な蛍光体を含む日焼け用ランプとして使用される放電ランプおよびSMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)の様な蛍光体を含む、ジアゾ複写、リソグラフ、誘虫、光化学および硬化工程の為の特殊ランプとして使用される放電ランプの蛍光体(1重量%以下の鉛)中の付活剤としての鉛
- ⑲小型化したコンパクト形省エネルギーランプ(ESL)の主アマルガムとしてのPbBiSn-HgおよびPbInSn-Hg、補助アマルガムとしてのPbSn-Hgに含まれる鉛
- ⑳液晶表示器(LCD)用平面蛍光ランプの前面基板と後面基板の接合に使用されるガラス中の酸化鉛

クロメート処理内容確認書

回答日	
-----	--

会社名	
部署名・役職	
住所	
責任者	

責任者印

クロメート処理について、下記項目を確認の上、回答をお願いします。

1	クロメート処理原液の名称を教えてください。	原液名：
2	クロメート処理原液に六価クロムは、混入していませんか？	はい・いいえ
3	六価クロメート処理工程がありますか？	はい・いいえ
3.で「はい」と答えた会社にお尋ねします。		
4	処理工程は、別々の処理槽を使用していますか？	はい・いいえ
5	六価クロメート処理をした製品が混在していませんか？	はい・いいえ
6	東芝キャリア(株)に納品するすべてのクロメート処理製品は、六価クロムが使用していない事が保障できますか？	はい・いいえ

Toshiba Carrier Corporation RoHS regulated substances survey table (non-content certificate)

Response date: _____ YYYY/MM/DD

Name of company	
Name of post / duty	
Address	
Person in charge	

Filled out by	
TEL	
FAX	
E-MAIL	
Comments	

Seal of the person in charge

Toshiba Carrier guarantees that the following responses are correct.

Figure number	Name of Parts	Name of manufacturer	Manufacturer die number	Mass (g)	Determination of RoHS threshold value OK, NG

Details of using part Toshiba Carrier is engaging in the target of making efforts to 50% of RoHS threshold value which should make the content in regulated substances close to zero.

No	Using part (Name of structural parts)	Material	RoHS regulated substances percentage content in each part (ppm)						Analysis data No.	Non-content certificate No.	Reason for containing regulated substances (includes excluded from application)	Excluded from application No.	Determination of RoHS regulated threshold value OK, NG	Mass (g)	Comments						
			Cadmium and compounds thereof*1	Cd	Hexavalent chromium compounds thereof	Cr+VI	Lead and compounds thereof	Pb								Mercury and compounds thereof	Hg	Polybrominated biphenyls	PBB	Polybrominated diphenyl ethers	PBDE
			Under 100		Under 1000		Under 1000*2									Under 1000		Under 1000		Under 1000	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					

Note 1) Definition of using part
 Using part refers to substances in a state not capable of being separated mechanically or what was disassembled into a material that cannot be separated mechanically.
 *1 Not being able to disassemble mechanically refers to what cannot be separated according to mechanical operations such as unscrewing, cutting, crushing, pulverizing, grinding, etc.
 *2 Percentage content calculation example (for details, refer to the sheet with calculation examples)
 [1] Chromate treated screw / plated steel sheets → plated layers can be separated
 [2] Leads of electronic parts that were solder plated → solder can be separated
 [3] Substances added in resin parts, etc. → separation is not possible

Note 2) Cadmium content
 There may be cases of cadmium being contained in brass as impurity. Use the control materials and verify that it is 0.01% or less. (Take caution particularly when using recycled materials.)
Note 3) Examples of application exception [Threshold value of lead]
 • Lead up to 0.35wt% in steel materials
 • Lead up to 0.4 wt% in aluminum materials
 • Lead up to 4 wt% in copper alloy materials

東芝開利RoHS限制物質調查表(不含有證明書)

回答日 YYYYY/MM/DD

公司名	
部署・職位	
地址	
責任人	

記入人	
TEL	
FAX	
E-MAIL	
備注	

責任人簽章

本公司保證以下的內容完全無誤。

圖號	部品名稱	製造商	製造商型號	質量(g)	RoHS限量值判定 OK, NG

使用部位的詳細內容 東芝開利努力將產品中的限制物質含有值降為零, 致力以RoHS限量值的50%為目標。

No	使用部位 (構成部品名)	材質	各部位RoHS受限物質限量值(ppm)					分析報告書No	不含有證明書No	限制物質的含有理由 (包括在豁免清單中)	豁免清單No.	RoHS指令限量值判定OK, NG	重量(g)	備考	
			鎘及其化合物*1 Cd	六價鉻化合物 Cr+VI	鉛及其化合物 Pb	水銀及其化合物 Hg	多溴聯苯類 PBB								多溴二苯醚類 PBDE
			100以下	1000以下	1000以下*2	1000以下	1000以下								1000以下
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

注1) 使用部位的定義
 使用部位是指用機械式分離到不能分離的物質或材料的部品。
 * 1 機械式分離是指使用旋鬆, 切斷, 破碎, 粉碎, 及研磨等的機械式操作分離的意思。
 * 2 含有率算出的範例(細節參照算出範例書)
 ① 鍍表面處理的螺釘/鍍金鋼板等→鍍金屬是有可能分離
 ② 電子部品的焊錫鍍金鉛→焊料是有可能分離
 ③ 添加在樹脂部品等的物質→是不可能分離

注2) 鎘的含有
 黃銅中有含有不純物的情況、確認使用的管理材在100ppm以下。
 (1) 回收材料的使用時要特別注意。
注3) 豁免清單例
 [「鉛的關值」]
 ・鋼材中的鉛不可超過0.35wt%
 ・鋁材中的鉛不可超過0.4wt%
 ・銅合金材的鉛不可超過4wt%
 ・電子部品的光學玻璃及陶瓷元件中可含有鉛
 ・高融點型焊料(鉛含有率在85%以上)可含有鉛